

# 大電流・高放熱プリント配線板

産業機器や車載PCUなどのパワーエレクトロニクス機器向け  
高温環境対応基板ソリューション

## 熱環境対応材料

高密度・小型化による設置環境温度の上昇に対応

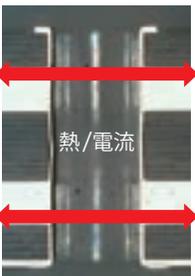
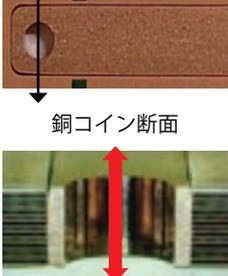
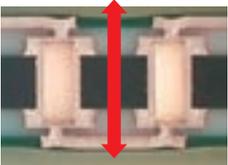
- 材料の耐熱性（ガラス転移点 = Tg）の改善  
Tg = 200℃を超える材料への対応
- 要求仕様に合わせた材料の選択が可能  
日系材料のみでなく、海外材料の適用も可能



## 大電流・高放熱対応

大電流・高放熱などの様々なニーズに、最適技術でご提案

- 厚銅基板では、一般的なプリント配線板材料による積層成型が可能で、基板側面への導体露出なし
- スポット熱対策に銅コイン基板、熱拡散に高熱伝導材料で対応
- 半導体パッケージ用基板から大型基板（480mm×580mmまで）に対応

適用技術 (主な仕様)		①厚銅基板 (内蔵導体厚 [μm] : 175、300、500、1,000 )	②銅コイン基板 (内蔵銅コイン形状 [mm] : φ 3.0 ~ φ 8.0、長方形 )	③高熱伝導材料	①+③組み合わせ 応用例
特長	放熱パス	水平方向	垂直方向	垂直方向	水平+垂直方向
	電流パス	水平方向	(垂直方向)	—	水平方向
実施例/断面図		銅厚 : 500μm × 2 	銅コイン : 長方形 	高熱伝導樹脂  熱伝導率 2.0 ~ 3.2W/mK	厚銅+高熱伝導樹脂 